

DWG. NO.
SD-52018-003

F

D

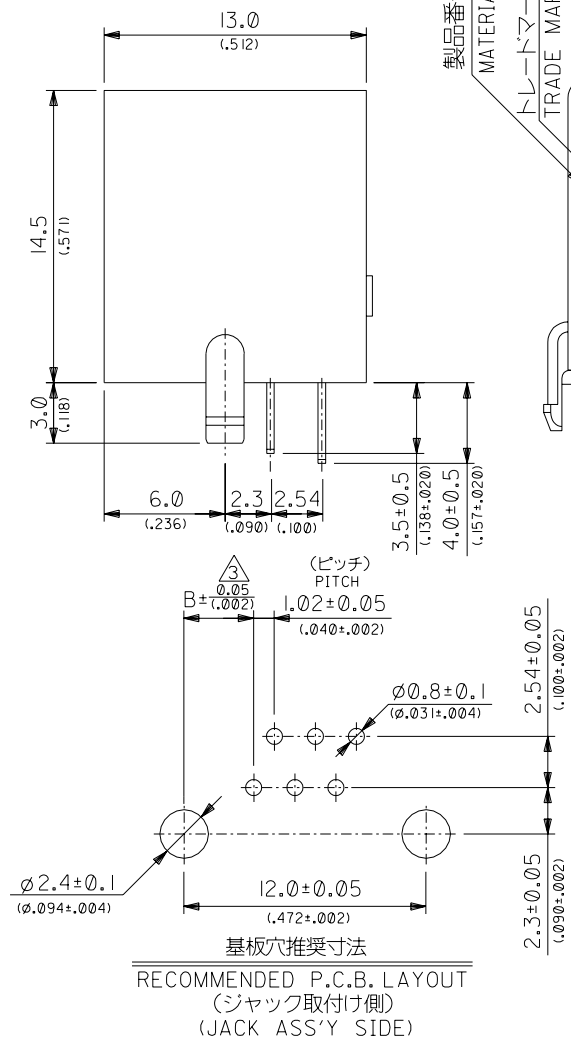
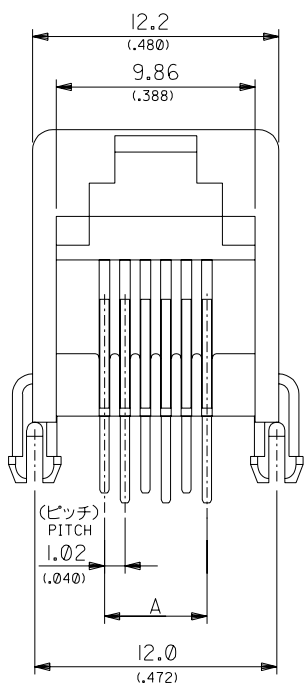
V

C

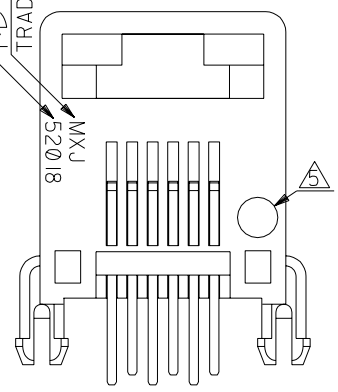
B

DO NOT SCALE DRAWING

164NO. DRWN: CH'K: APPR:		163NO. DRWN: CH'K: APPR:		162NO. DRWN: CH'K: APPR:		161NO. DRWN: CH'K: APPR:		新規作成 RELEASED 160NO. J2004-4221 DRWN: M. NAGATA '04/05/14 CH'K: K. TOJO '04/05/14 APPR: M. SASAO '04/05/14		DESCRIPTION 0		REV		MATERIAL 材料		FINISH 仕上げ		WIRE RANGE 適用電線範囲		INS. RANGE 被覆外径		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE 4:1		DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH		DRAWN BY & DATE M. NAGATA '04/05/14		CHECKED BY & DATE K. TOJO '04/05/14		APPROVED BY & DATE M. SASAO '04/05/14		CAD FILENAME SD-52018-003.S01		MATERIAL NO. SEE CHART		DRAWING NO. SD-52018-003		SHEET NO. 1 OF 1		SIZE B		2885 DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		EN-02J(097) MXJ-54	
注参照 SEE NOTES														注及び表参照 SEE NOTES AND CHART				— # —		— # —		ANGLE 角度		±3°		MOLEX INCORPORATED		TITLE: MODULAR JACK HOUSING ASS'Y -LEAD FREE-																			



製品番号
MATERIAL NO.
トレードマーク



注) NOTES
1. 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリアステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µm MIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µm MIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
△ - 6.4*6は両端の基板穴を除く。
△ - 6.2*6は両端の2つの基板穴を除く。
DIM B INDICATES FIRST P.C.HOLE
REQUIRED PER PART NUMBER.
FOR PARTIALLY LOADED ASSEMBLIES
P.C.HOLE PATTERN IS REDUCED FROM EACH END.
4. 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
△ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µm MIN. YELLOW: 0.1 MICROMETER MINIMUM.
緑色: 0.38µm MIN. GREEN: 0.38 MICROMETER MINIMUM.
オレンジ色: 0.76µm MIN. ORANGE: 0.76 MICROMETER MINIMUM.
無色: 1.27µm MIN. UNMARKED: 1.27 MICROMETER MINIMUM.
6. ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
7. 本製品は52018-6**5の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-6**5.

6	6	5.08 (.200)	3.46 (.136)	1.27 / (50)	52018-6646
				0.76 / (30)	↑ -6636
				0.38 / (15)	-6626
				0.1 / (4)	-6616
6	4	3.05 (.120)	4.48 (.176)	1.27 / (50)	-6446
				0.76 / (30)	-6436
				0.38 / (15)	-6426
				0.1 / (4)	-6416
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	1.27 / (50)	-6246
				0.76 / (30)	-6236
				0.38 / (15)	↓ -6226
				0.1 / (4)	52018-6216
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	A	B	金メッキ厚 (µMIN) GOLD PLATING THK(MIN.) µm/(µMIN)	製品番号 MATERIAL No.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex:](#)

[52018-6616](#)